

技术参数

5920

日期 : 07/2022
上海禧合应用材料



应用介绍

特点 一款单组份环氧树脂胶，低温固化快，流平性好，适用于电子产品多种材料的结构性粘接。

粘接材料 金属，陶瓷，塑料/PCB，玻璃等

典型应用 电子元器件结构性粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	3200	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	2mins@150°C 4mins@120°C 60mins@75°C	
有效期@ -20°C,月	6	

*固化温度是指达到胶水表面的实际温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	65D	ASTM D-2240
玻璃化温度 Tg	25°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	

储存和使用方法

产品需低于-20°C环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

